

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成30年4月19日(2018.4.19)

【公開番号】特開2015-187720(P2015-187720A)
 【公開日】平成27年10月29日(2015.10.29)
 【年通号数】公開・登録公報2015-066
 【出願番号】特願2015-47000(P2015-47000)
 【国際特許分類】

G 0 9 F 9/00 (2006.01)
 H 0 1 L 21/8234 (2006.01)
 H 0 1 L 27/088 (2006.01)
 H 0 1 L 27/08 (2006.01)
 H 0 1 L 27/06 (2006.01)
 H 0 1 L 21/02 (2006.01)
 H 0 1 L 27/12 (2006.01)
 G 0 9 F 9/30 (2006.01)
 H 0 1 L 51/50 (2006.01)
 H 0 5 B 33/14 (2006.01)
 H 0 5 B 33/06 (2006.01)
 H 0 5 B 33/04 (2006.01)
 H 0 5 B 33/10 (2006.01)

【 F I 】

G 0 9 F 9/00 3 4 2
 H 0 1 L 27/08 1 0 2 C
 H 0 1 L 27/08 3 3 1 E
 H 0 1 L 27/06 1 0 2 A
 H 0 1 L 27/12 B
 G 0 9 F 9/30 3 6 5
 G 0 9 F 9/30 3 3 8
 G 0 9 F 9/00 3 6 6 A
 H 0 5 B 33/14 A
 H 0 5 B 33/14 Z
 H 0 5 B 33/06
 H 0 5 B 33/04
 H 0 5 B 33/10

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月6日(2018.3.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】表示装置の作製方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フレキシブル基板上に第 1 の電極及び第 2 の電極を有し、
前記第 1 の電極上に E L 層を有し、
前記第 2 の電極上に剥離層を有し、
前記 E L 層上及び前記剥離層上に接着層を有し、
前記接着層上にガラス基板を有し、
前記フレキシブル基板から前記ガラス基板を剥離する工程において、前記剥離層及び前記剥離層上の前記接着層は、前記ガラス基板と一緒に剥離され、
前記剥離工程によって、前記フレキシブル基板上の第 2 の電極が露出され、
前記露出後に、前記第 2 の電極は、外部電極と電氣的に接続され、
前記 E L 層は、前記剥離層と同一工程で形成されることを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 2】

表示領域を有する表示装置の作製方法であって、
第 1 乃至第 7 の工程を有し、
前記第 1 の工程は、第 1 の基板の第 1 の表面上に、第 1 の層を設ける工程と、前記第 1 の層上に第 1 の絶縁層を設ける工程と、前記第 1 の絶縁層上に電極を設ける工程と、前記電極上に第 2 の絶縁層を設ける工程と、前記第 2 の絶縁層の一部を除去して第 1 の開口を設ける工程と、前記第 2 の絶縁層上に表示素子および第 2 の層を設ける工程と、を有し、
前記第 2 の工程は、第 2 の基板の第 2 の表面上に、第 3 の層を設ける工程と、前記第 3 の層上に第 3 の絶縁層を設ける工程と、前記第 3 の層および前記第 3 の絶縁層の一部を除去して第 2 の開口を設ける工程と、を有し、
前記第 3 の工程は、前記第 1 の表面と前記第 2 の表面を向かい合わせ、前記第 1 の開口と前記第 2 の開口とが互いに重なる領域を有するように、接着層を介して前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを互いに重ねる工程を有し、
前記第 4 の工程は、前記第 1 の基板を前記第 1 の層とともに前記第 1 の絶縁層から剥離する工程を有し、
前記第 5 の工程は、前記第 1 の絶縁層と第 3 の基板とを互いに重ねて前記第 3 の基板を設ける工程を有し、
前記第 6 の工程は、前記第 2 の基板を前記第 3 の層とともに前記第 3 の絶縁層から剥離する工程を有し、
前記第 7 の工程は、前記第 3 の絶縁層と第 4 の基板とが互いに重なるように前記第 4 の基板を設ける工程を有し、
前記第 1 の工程において、前記電極と前記第 2 の層は互いに少なくとも一部を接して設けられ、
前記第 3 の工程において、前記接着層は、前記接着層と前記第 2 の開口とが互いに重なる第 1 の領域を有し、前記第 2 の層は、前記第 2 の層と前記第 2 の開口とが互いに重なる第 2 の領域を有し、
前記第 6 の工程において、前記第 1 の領域の少なくとも一部の前記接着層と、前記第 2 の領域の少なくとも一部の前記第 2 の層と、を前記第 2 の基板とともに剥離し、
前記電極の少なくとも一部が露出することを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 2 において、
前記第 2 の層は、
E L 層及び導電層の積層であることを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 2 または請求項 3 において、
前記第 1 の基板は、
ガラス基板、石英基板、サファイア基板、セラミック基板、金属基板、半導体基板、ま

たはプラスチック基板を有し、

前記第 2 の基板は、

ガラス基板、石英基板、サファイア基板、セラミック基板、金属基板、半導体基板、またはプラスチック基板を有することを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 5】

請求項 2 乃至請求項 4 のいずれか一項において、

前記第 3 の基板および前記第 4 の基板は、

可撓性を有することを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 2 乃至請求項 5 のいずれか一項において、

前記第 1 の層は、

タングステン、モリブデン、チタン、タンタル、ニオブ、ニッケル、コバルト、ジルコニウム、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、またはシリコンを有し、

前記第 3 の層は、

タングステン、モリブデン、チタン、タンタル、ニオブ、ニッケル、コバルト、ジルコニウム、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、またはシリコンを有することを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 7】

請求項 2 乃至請求項 6 のいずれか一項において、

前記表示素子は、発光素子であることを特徴とする表示装置の作製方法。